

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

SPECYFIKACJA:

Automat pick and place obligatoryjnie powinien :

- posiadać głowicę z dwoma dyszami z systemem optycznego centrowania "w locie";
- posiadać możliwość układania komponentów o wielkości minimum 0201 do 50x50mm (BGA);
- zawierać dyspenser pasty lutowniczej;
- zawierać pneumatyczny lub wibracyjny podajnik na komponenty pakowane w laskach;
- posiadać możliwość pobierania komponentów z tacek;
- posiadać możliwość instalacji nie mniej niż 60 szt. podajników komponentów 8mm z taśmy
- posiadać podajniki obsługujące komponenty z taśmy w ilości: a) 8mm – 35szt; b) 12mm – 2szt; c) 16mm – 1szt.
- posiadać wydajność nie mniejszą niż 4400 CPH (komponentów na godzinę)
- obsługiwać komponenty: CHIP od 0201, MELF oraz MINI MELF; Diody, SOT; Układy scalone do 40mm; Trymery, induktry oraz aluminiowe kondensatory elektrolityczne;
- posiadać obszar roboczy nie mniejszy niż 440 x 360 mm;
- posiadać rozdzielczość (dokładność pozycjonowania komponentów): dla osi X / Y – o wartości nie większej niż 0,01mm ;
- zawierać głowicę z minimum 2 dyszami do pobierania komponentów;
- posiadać możliwość automatycznej zmiany ssawek;
- być urządzeniem w wersji wolnostojącej;
- powinien zawierać polską instrukcję .